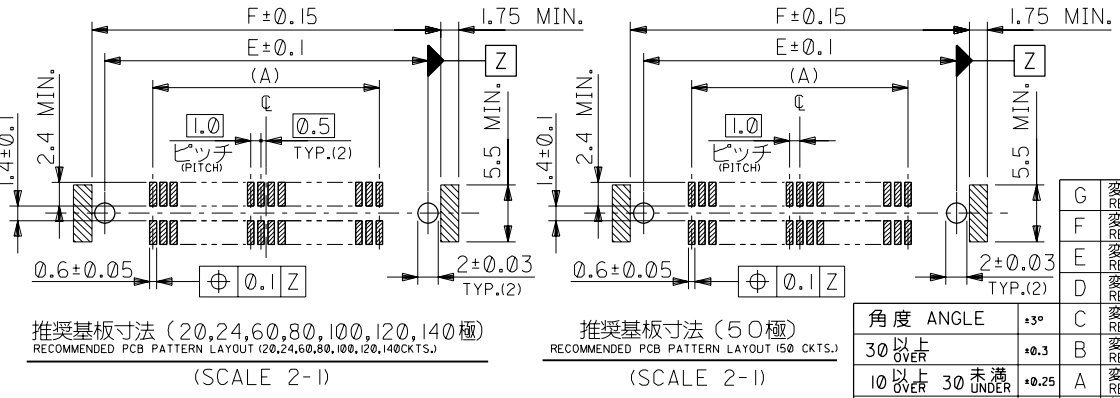
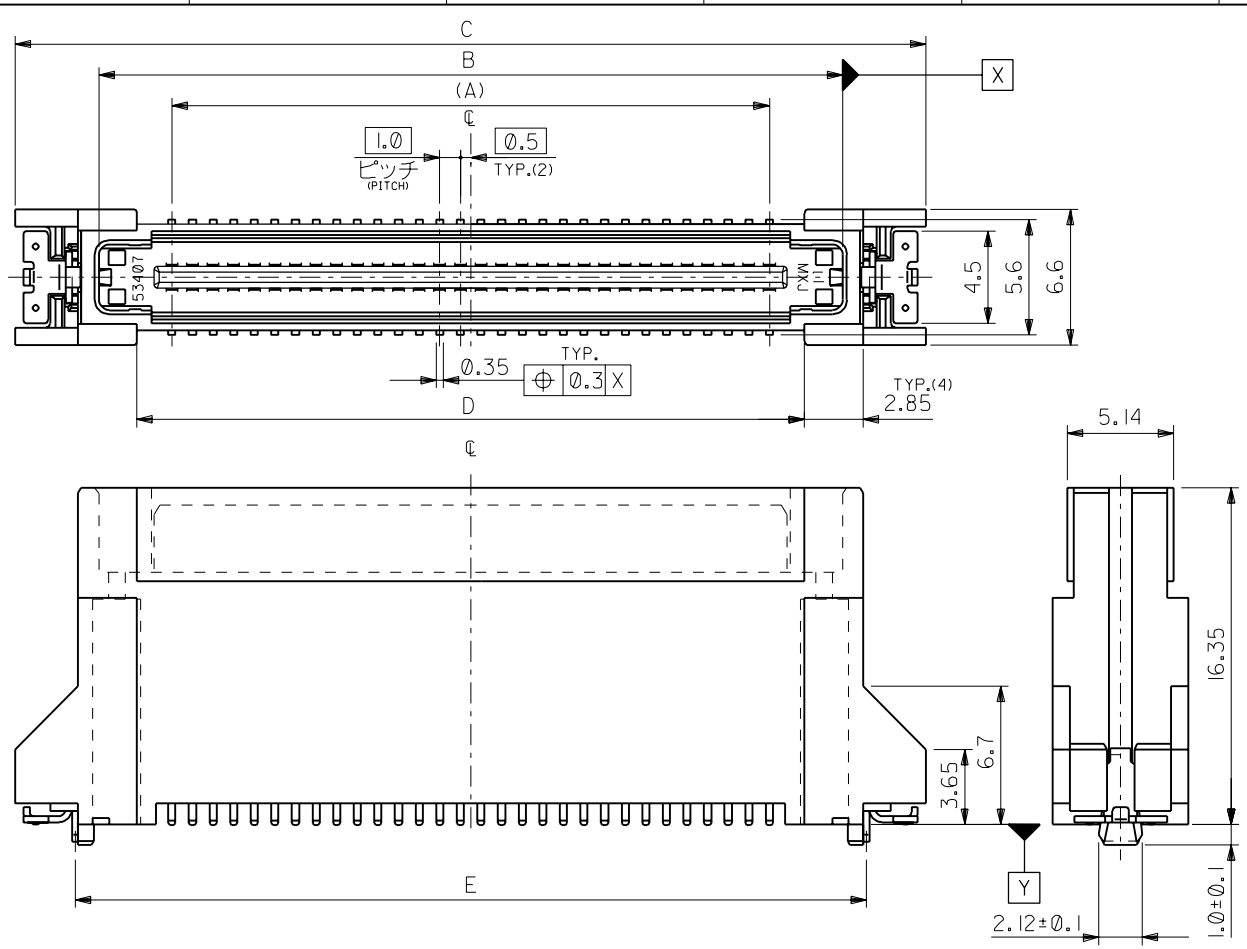


DWG. NO. SD-53408-***0

ALL DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING



推奨基板寸法 (20, 24, 60, 80, 100, 120, 140極)
RECOMMENDED PCB PATTERN LAYOUT (20, 24, 60, 80, 100, 120, 140CKTS.)
(SCALE 2-1)

推奨基板寸法 (50極)
RECOMMENDED PCB PATTERN LAYOUT (50 CKTS.)
(SCALE 2-1)

角度 ANGLE	±3°
30°以上 OVER	±0.3
10°以上 OVER 30°未滿 UNDER	±0.25
未滿 UNDER	±0.2
① 新規作成 RELEASED	
② 変更内容 REVISION RECORD	
③ 一般公差 GENERAL TOLERANCES	

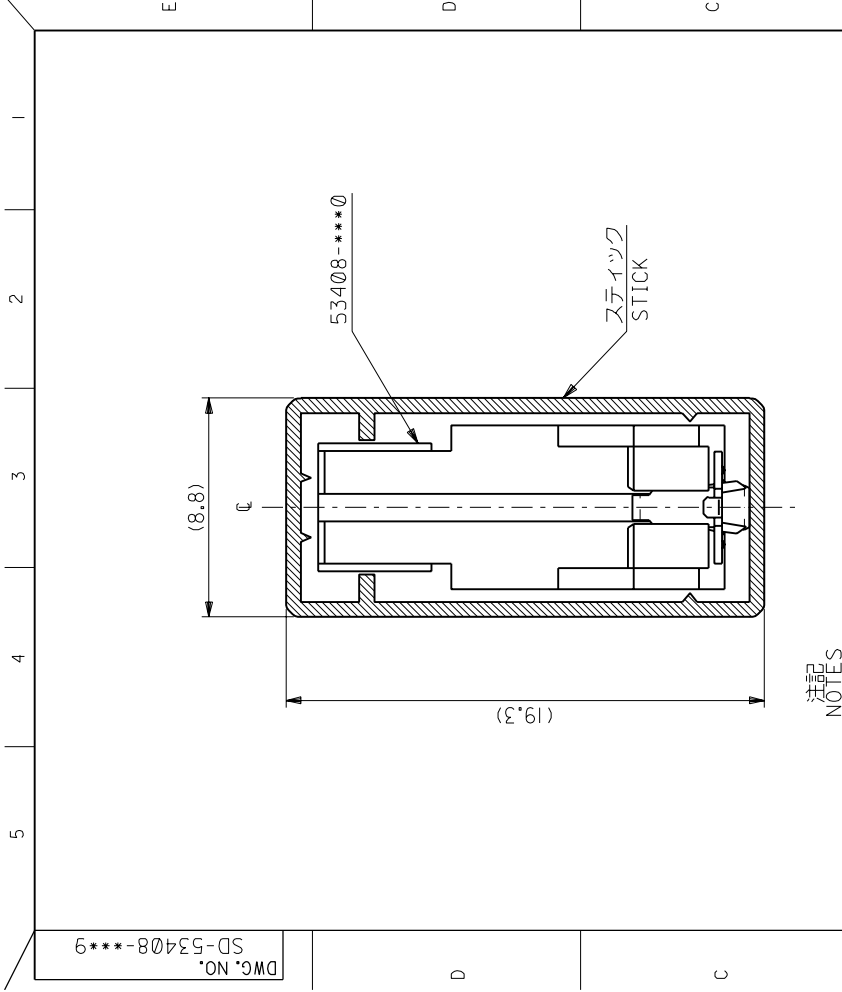
記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE
G	変更 (JD2001-1424)	T.H.	10/24/19
F	変更 (JD60150)	J.M.	195/08/10
E	変更 (T40044)	S.A.	194/01/27
D	変更 (T30585)	S.M.	193/12/1
C	変更 (T30434)	S.M.	193/9/8
B	変更 (T30355)	J.M.	193/7/15
A	変更 (T30275)	S.M.	193/6/8
①	新規作成 RELEASED	H.H.	193/2/18

材料 MATERIAL	注参照 SEE NOTES
仕上げ FINISH	注参照 SEE NOTES
適用電線範囲 WIRE RANGE	—
被覆外径 INS. RANGE	—
DRAWN BY	CHK'D BY
APP'D BY	尺度 SCALE 4-1

molex MOLEX-JAPAN CO., LTD. 日本モレックス株式会社	
REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
TITLE 名称 1.0 B-T-O-B S/T PLUG HS'G ASS'Y	
DWG. NO. SD-53408-***0	REV G

- 注) 1. 材質 MATERIAL
ハウジング: ガラス入りLCP、白色、UL94V-0
ターミナル: 燐青銅 (t = 0.2)
TERMINAL: PHOSPHOR BRONZE
金属ペグ: 燐青銅
METAL PEG: PHOSPHOR BRONZE
2. ヌッキ仕様 PLATING
ターミナル 接点部: 金メッキ 0.25 μmMIN.
TERMINAL CONTACT AREA: GOLD 0.25 μmMIN.
半田付け部: 半田メッキ 1.0 μmMIN.
SOLDER TAIL AREA: TIN-LEAD 1.0 μmMIN.
下地メッキ: ニッケルメッキ 2.0 μmMIN.
UNDER-PLATING: NICKEL 2.0 μmMIN.
金属ペグ 半田付け部: 半田メッキ 3.5 μmMIN.
METAL PEG SOLDER TAIL AREA: TIN-LEAD 3.5 μmMIN.
3. 推奨基板厚 RECOMMENDED PCB THICKNESS
1.0 ± 0.1mm MIN.
4. テールのバラツキ寸法 TAIL COPLANARITY
テールは、Y面を基準とし、上へ 0.02 下へ 0.15 の範囲にのみ、且つテール平坦度は 0.15 とする。
TAILS TO BE WITHIN 0.02 UPWARD AND 0.15 DOWNWARD FROM Y-DATUM PLANE, AND TAIL COPLANARITY TO BE 0.15.
5. ロックは、20、24、50極に設置する。
LOCK TO BE ADDED TO 20, 24 AND 50 CKTS.
6. 梱包 PACKAGING
本製品はスティック梱包とし梱包後のENG. NO. は 53408-***9とする。
THIS PRODUCTS TO BE PACKED IN TUBE. ENG. NO.: 53408-***9
7. 同一基板内に複数個 (2ヶ以上) の使用は避けてください。
MXJ DOES NOT RECOMMEND THE USAGE OF TWO OR MORE OF THESE CONNECTORS BETWEEN A SINGLE PAIR OF P.C.BOARD.

80.9	78.4	72.4	84.2	76.02	69	53408-1400	140
70.9	68.4	62.4	74.2	66.02	59	53408-1200	120
60.9	58.4	52.4	64.2	56.02	49	53408-1000	100
50.9	48.4	42.4	54.2	46.02	39	53408-0800	80
40.9	38.4	32.4	44.2	36.02	29	53408-0600	60
35.9	33.4	27.4	39.2	31.02	24	53408-0500	50
22.9	20.4	14.4	26.2	18.02	11	53408-0240	24
20.9	18.4	12.4	24.2	16.02	9	53408-0200	20
F	E	D	C	B	(A)	ENG. NO.	種数 NO. OF CKTS.



DWG. NO. SD-53408-***9

A DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

6	53408-1409	140
7	53408-1209	120
8	53408-1009	100
10	53408-0809	80
13	53408-0609	60
14	53408-0509	50
21	53408-0249	24
23	53408-0209	20

角度	ANGLE	±3°
30以上 OVER		+0.3
10以上 UNDER		+0.25
10以下 UNDER		+0.2

一般公差
GENERAL TOLERANCES

G	変更	(JIS B 0200-1-1624)	K,T,H	01/04/79
F	変更	(JIS B 0150)	M,N	05/08/78
E	変更	(JIS B 0648)	V,A	03/12/74
D	変更	(JIS B 0585)	J,M	03/12/71
C	変更	(JIS B 0585)	M,S	03/11/75
B	変更	(JIS B 0434)	M,S	03/12/78
A	変更	(JIS B 0275)	M,S	03/12/78
0	新規作成 RELEASED	(JIS B 010)	M,S	03/12/73

材料	MATERIAL	01/04/79
スティック	ポリ塩化ビニル STICK : P.V.C.	05/08/78
仕上げ	FINISH	03/12/74
適用電線範囲	WIRE RANGE	03/12/71
液層外径	INS. RANGE	03/11/75
液層内径	INS. RANGE	03/12/78
DRAWN BY	CHK'D BY	03/12/73
J. Inoue	/I. Inoue	
APP'D BY	SCALE	
5-1	5-1	

MOLEX-JAPAN CO.,LTD. モレックス株式会社
REVISE ONLY ON CAD SYSTEM
TITLE 名称
53408-***0 STICK PACKAGING
DWG. NO. SD-53408-***9
REV G

注記
NOTES

- スティック両端はキャップ止め。
BOTH ENDS WITH CAPS.
- 全長: 600±2
TOTAL LENGTH
- 肉厚: 0.6±0.2
THICKNESS

数量	ENG. NO.	繰数
NO. OF PKTS.		NO. OF CKTS.

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面はモレックス(株)の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。
FN-0117(07)クIMX.I-33